

N800BH

ノンシリコン熱伝導シート

LiPOLY N800BH はノンシリコン樹脂の材料で作りました。低分子シロキサの揮発は少ないので、電子回路接点不良という状況はなりません。N800BH は良い熱伝導性があって、熱伝導率は 11.0 W/m*K です。熱抵抗も低いて、光学製品や敏感な電子部品の使用には適合です。

■ 製品の特性

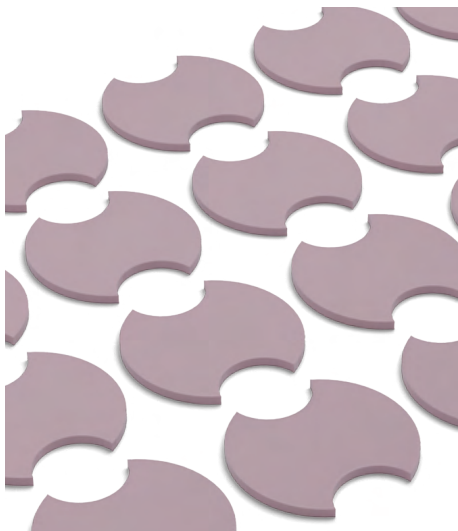
- / 熱伝導率: 11.0 W/m*K
- / ノンシリコン材料
- / 接触熱抵抗が小さい
- / 電気絶縁
- / 優れる熱伝導率
- / 光学デバイスに適合

■ 製品アプリケーション

- / ハードディスク
- / 光学デバイス
- / 5Gの基地局(基幹施設/設備)
- / 電気自動車

■ 製品の形

- / シート状
- / フォーミング形



■ 代表特性

物理特性	N800BH	試験方法	単位
色	Pink	Visual	-
表面粘着性 (2面 / 1面)	2	-	-
厚さ	Customized	ASTM D374	mm
密度	3.3	ASTM D792	g/cm ³
硬さ	50	ASTM D2240	Shore OO
使用温度	-60~125	-	°C
低分子シロキサン (D3~D20合計)	N.D	Gas Chromatography	%
脱ガス CVCM (wt%)	0.0047	By LiPOLY	-
質量損失比	<0.04	By LiPOLY	%
ROHS & REACH	Compliant	-	-
圧縮特性@1.0mm			
圧縮率 @10 psi	13	ASTM D5470 modify	%
圧縮率 @20 psi	34	ASTM D5470 modify	%
圧縮率 @30 psi	65	ASTM D5470 modify	%
電気特性			
絶縁破壊電圧	8	ASTM D149	KV/mm
表面抵抗率	>10 ¹¹	ASTM D257	Ohm
体積抵抗率	>10 ¹⁰	ASTM D257	Ohm-m
熱特性			
熱伝導率	11.0	ASTM D5470	W/m*K
熱抵抗@10 psi	0.210	ASTM D5470	°C-in ² / W
熱抵抗@20 psi	0.148	ASTM D5470	°C-in ² / W
熱抵抗@30 psi	0.088	ASTM D5470	°C-in ² / W

環状ポリジメチルシロキサン (HO-[Si(CH₃)₂O]_n-H) は、化学反応が起こっていない状態でも、常温環境下で容易に揮発します。たとえば、密閉された電子機器内部では、低分子シロキサンが揮発して電子接点に付着し、接触不良を引き起こすおそれがあります。

熱抵抗 vs. 圧力 vs. 圧縮率

